

TAB (Tape Automatic Bonding)基板厂家 TAB工艺厂家封装IC

产品名称	TAB (Tape Automatic Bonding)基板厂家 TAB工艺厂家封装IC
公司名称	苏州恒迈瑞材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路60号(蠡盛大厦)507室(注册地址)
联系电话	15366208370

产品详情

TAB (Tape Automatic Bonding)基板厂家 TAB工艺厂家封装IC

苏州恒迈瑞是专业生产TAB封装基板厂家,除此外还提供COF卷带式封装基板。

TAB封装是一种将多接脚大规模集成电路器(IC)的芯片(Chip),不再先进行传统封装成为完整的个体,而改用TAB封装基板载体,直接将未封芯片黏装在板面上.即采聚酰亚胺"(PI)之软质卷带,及所附铜箔蚀成的内外引脚当成载体,让大型芯片先结合在"内引脚"上.经自动测试后再以"外引脚"对电路板面进行结合而完成组装.这种将封装及组装合而为一的新式构装法,即称为TAB基板封装工艺IC封装。